

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 28 年 1 月 28 日 (2016.1.28)

【公開番号】特開 2014-229855 (P2014-229855A)
 【公開日】平成 26 年 12 月 8 日 (2014.12.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-067
 【出願番号】特願 2013-110634 (P2013-110634)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 25/065 (2006.01)

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/08 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 27 年 12 月 7 日 (2015.12.7)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 2 8】

このようにして、金属板 1 0 の上面側に、中央部に部品接続用パッド P 1 を備え、中央部の周囲に外部接続用パッド P 2 を備えた複数の配線層 2 0 を形成する。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 6 2
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 6 2】

以上により、実施形態の電子部品装置 1 が得られる。図 1 3 に示すように、本実施形態の電子部品装置 1 は、下面が大気に露出した状態の配線層 2 0 を備えている。配線層 2 0 は、中央部に部品接続用パッド P 1 を備え、中央部の周囲に外部接続用パッド P 2 を備えている。部品接続用パッド P 1 は引き出し配線部 W を介して外部接続用パッド P 2 に接続されている。複数の配線層 2 0 の間の領域には永久レジスト層 1 2 が配置されている。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 8 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 8 5】

また、図 1 8 に示す第 2 変形例の電子部品装置 1 b のように、封止樹脂 5 0、半導体素子 4 0 及び枠部材 3 0 を削ることにより、半導体素子 4 0 の背面を露出させてもよい。これにより、電子部品装置 1 b の厚みを薄くすることができる。例えば、半導体素子 4 0 の厚みが 5 0 μ m ~ 3 0 μ m になるように加工される。